

KDB TechConnect Day 개최 안내

전략적 투자유치 · 제휴 희망기업을 찾습니다

(사)벤처기업협회·(주)에스와이피·KDB산업은행은 신성장기술이 필요한 대·중견기업과 사업화자금 및 네트워크가 필요한 스타트업 간의 전략적 제휴를 지원하기 위하여 공동으로 KDB TechConnect Day를 개최합니다.

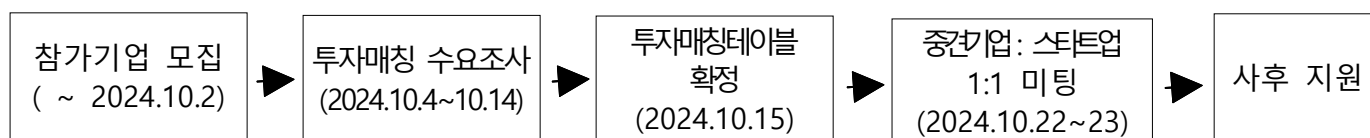
전략적 투자유치 또는 제휴를 희망하는 **소재·부품·장비·헬스케어** 기술의 스타트업은 대·중견기업의 투자희망기술 분야를 참조하여 첨부된 신청서로 많은 참여를 부탁드립니다.

□ 대·중견기업의 투자희망기술 분야

참여 대·중견기업* 분류	투자희망기술 분야
소재·화학 (이녹스, 포스코기술투자, 조광페인트, 금호석유화학, 이엔에프테크놀로지 등)	1. 반도체, 차세대 디스플레이 및 기타 IT向 첨단 소재 2. 2차전지 소재 및 사용 후 진단, 재활용, 안전 기술 3. 기능성 코팅 소재, 점·접착제용 소재 및 친환경 페인트
부품·장비 (HL홀딩스, 한국무라타전자, 진성티씨, CKD창업투자 등)	1. 스마트폰, 디스플레이, 2차전지, 자동차 전장용 부품 2. 로봇 및 인공지능을 활용한 자율주행 3. 반도체 패키징, 팹리스 기술 3. 물류 최적화 및 효율화 기술
바이오·헬스케어 (대원제약, 휴온스 그룹, 웰스투자 등)	1. 개량신약, 신약 pipe-line 가능한 물질 2. 의료기기, 디지털헬스케어 3. 건강 기능성 식품, Food Tech 4. 첨단바이오의약품 제조를 위한 소재·부품·장비

※ 미팅 희망기업이 없을 경우, 불참할 수도 있음

KDB TechConnect Day 추진 일정



- 문 의 KDB산업은행 넥스트라운드실 임창도 파트장(02-787-6166, cdihm@kdb.co.kr)
벤처기업협회 이현주 대리(02-6331-7088, hjlee@kova.or.kr)
에스와이피 김홍수 본부장(010-6506-2141, 535kim1@hanmail.net)
- 신 청 첨부된 신청서 작성 후 cdihm@kdb.co.kr로 e-mail 접수
- 미팅일시 2024년 10월 22일~23일 10시~18시(1회 미팅은 약 1시간 예정)
- 미팅장소 산업은행 본점 1층 고객접견실(여의도 국회의사당역 인근)
- 협력기관 한국기술벤처재단, 한국발명진흥회, 성균관대학교 산학협력단, 연구개발특구진흥재단
- 주의사항 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다

※ 참가희망기업이 첨부된 신청서로 담당자에게 신청하시면, 투자 수요조사를 통해 효율적인 매칭이 이루어지도록 하겠습니다. 매칭이 이루어지지 않는 경우, 미팅에 참석이 불가하나 행사 후 다른 대·중견기업과의 상담을 추진하겠습니다. 감사합니다^^.